

第十屆 IMPACT 國際電子構裝暨電路板研討會 10/3 前報名享早鳥優惠價

★穿戴裝置★物聯網★市場與技術趨勢★企業論壇★美日韓技術發表

來自全球 16 個國家 多達 200 餘篇前瞻論文 即將精彩登場

全台最盛大的國際電子零組件、組裝、封測、電路板產業的年度盛會-第十屆國際構裝暨電路板研討會(簡稱 IMPACT)，將於 10 月 21 至 23 日假台北南港展覽館舉辦，同期除了有全台最大電路板國際展覽(TPCA Show 2015)之外，而今年更結合軟性與印製電子國際會議(簡稱 ICFPE)共同合辦，讓本屆活動更加多元化。今年論壇豐富多元，有『六大主題演講』、『美日韓先進論壇』、『先進技術優秀論文』、『企業論壇』、『IoT 論壇』以及『穿戴式論壇』等豐富內容。IMPACT 2015 大會係由 IEEE CPMT-Taipei、IMAPS-Taiwan、工研院及台灣電路板協會共同主辦。今年研討會主題將聚焦在「IMPACT on Mobile and Flexible Electronics」，即日起開放早鳥報名至 10 月 3 日止，是您不可錯過的國際年會，歡迎您把握早鳥優惠價踴躍報名參加!

時值十周年的 IMPACT，主題演講更邀請到來自美國 TechSearch 總裁 E. Jan Vardaman 主講“Packaging Trends for Wearable Medical Electronics”，另有日本 IBM Research Tokyo 資深經理 Yasumitsu Orii 將演講“Challenge of Packaging Technologies in the era of Cognitive Computing”，另外，今年規畫三大企業論壇，除了首日登場的日月光企業論壇將再度引爆先進構裝的技術交流之外，10 月 22 日上午有矽品之企業論壇，本期聚焦於「先進封裝技術 2.5D IC, SiP, Fan-out, and NTI (No TSV Interposer)」，而當日下午則有美商 Intel 企業論壇，論壇主軸為「Intel Data Center Design Strategy」，一連三天接棒登場，議程豐富，值得您期待。而特別論壇除了規劃日本【ICEP 封裝論壇】、美國【iNEMI 論壇】、【韓國論壇】之外，今年同場加映日本東京大學須賀唯知(Tadatomo Suga)教授所規畫之“表面活化接合(Surface Activated Bonding; SAB)”技術發表，以及由美國 Charles Bauer 博士所主導之“扇出(Fan-out)預測成本模型”等討論議題。除了豐富的特別主題論壇之外，也有多篇來自構裝與電路板領域之優秀論文獎的發表，您將不虛此行。而企業贊助夥伴除了有台灣封裝雙雄日月光及矽品之外，還有來自化學廠阿托科技及陶氏化學、電路板廠先豐通訊、軟板材料亞洲電材、乾膜廠長興材料等熱情贊助，今年新加入了美商 Intel 及日商 JSR 共襄盛舉。IMPACT 儼然已成為台灣唯一橫跨上游材料、電路板、半導體、封裝測試領域的國際級研討會，眾多產業大廠齊聚，邀您共同與會。

今年國際電子構裝暨電路板研討會投稿論文和邀請演講共計 213 篇，其中有 84 篇來自國外投稿，可見 IMPACT 研討會已具備國際性與代表性。大會統計今年來自海外之國際廠商、學術及調查研究機構等參與度再創新高，外國講師比重占四成，投稿者來自澳洲、德國、法國、美國、荷蘭、印度、菲律賓、以色列、馬來西亞、日本、南韓、泰國、新加坡、中國、香港和台灣等 16 個地區投稿，成為國內封裝、PCB、微系統產業及其前瞻技術發展與互動一個最佳的交流平台，學術發表、技術轉型、國際合作、創造價值，IMPACT 研討會帶給您多樣風貌及國際觀點! 10 月 3 日早鳥報名優惠截止，年度盛會，不容錯過，歡迎各界踴躍報名，一次掌握從設計應用到材料研發的兩百多場演講，一律網路報名，報名資訊請洽台灣電路板協會邱小姐(Jessie)，電話: +886 3 381 5659 #406、E-Mail: register@impact.org.tw、網路報名請直接上 IMPACT 官網 www.impact.org.tw。